

產品資訊

智動化服務

自動化零組件

自動化設備

節能安全



產品諮詢

連絡電話: 03-3223788 #290
Email:
info_photonic@aurotek.com

Laser Depaneling & Marking Machine Semi-Automatic LSO 3000G



產品資訊

規格

產品資訊

Dust Free ` Non-Contact Cutting

Laser Depaneling & Marking Machine

- ◆ Accuracy $\pm 25 \mu\text{m}$ (1 Mil)
- ◆ Axes Driving speed up to 1000mm/sec
- ◆ Laser marking & depaneling All-in-One
- ◆ Configurable Laser Source per demand
- ◆ Apply to Flexible, Rigid, Flex-rigid PCB

規格

項目	規格
Laser class	4
Accuracy	$\pm 25 \mu\text{m}$ (1 Mil)
Spot Size	20um
Laser Source (Configure per your demand)	10W Green laser (cutting thickness $\leq 0.6\text{mm}$)
Laser Source (Configure per your demand)	20W Green laser (cutting thickness $\leq 1.5\text{mm}$)
Laser Source (Configure per your demand)	12W UV laser (cutting thickness $\leq 1\text{mm}$)



Processing Table	2
Processing Table Size	380mm x 380mm
Operation Side	Front
Whole cutting area	350mm x 350mm
Single cutting area	50mm x 50mm
Applicable Panel thickness	Depending on laser source
Working temperature	23°C±2°C
Humidity	<70% (non-condensing)
Particle Extraction	filter
AXES	X, Y1, Y2, Z
Motors	AC brushless servo motors
Axis Speed	250mm/s
Power Supply	220V 3P+PE-50/60Hz, ±3%
Power Consumption	Depending on laser source
Air Pressure	0.6 MPa
Average Consumption	<10NI/min
Length x Width x Height	1400mm x 1400mm x 1500mm
Weight	Approx. 1000 Kg



Aurotek[®]

和椿科技股份有限公司
114 台北市內湖區洲子街 60 號 1 樓

Tel: +886-2-8752-3311
Email: info@aurotek.com

[產品資訊](#)

[智動化服務](#)
[自動化零組件](#)
[自動化設備](#)
[節能安全](#)

[媒體中心](#)

[最新消息](#)
[新聞媒體](#)

[關於和椿](#)

[和椿科技簡介](#)
[組織架構](#)
[重要里程碑](#)
[企業社會責任](#)
[人才招募](#)

[投資人專區](#)

[財務資訊](#)
[股務資訊](#)
[公司治理](#)

[聯絡我們](#)

[服務洽詢](#)
[亞太事業處](#)
[中國營業處](#)
[日本地區](#)
[友站連結](#)